

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他_____
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2026 半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 09 月 03 日 16:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 邱国良 总经理 邓迪 董事会秘书 邱靖琳 财务总监 谢学运 独立董事 严义 独立董事 谢园保
投资者关系活动主要内容介绍	1、邱董好！请问光模块产线设备订单情况和发展前景怎样？收入确认需要多长时间？ 答：您好！2026 年半年度柔性自动化业务实现营业收入 3,363.56 万元，同比增长 37.22%，其中光模块自动化组装线持续出货。同时公司积极布局光通信领域，推出用于 COC/COS/TO 等产品的脉冲加热共晶机，储备了光模块领域专用设备技术。感谢您的关注！

2、邓总好！请问公司订单情况如何？产线利用率怎样？对全年业绩公司有何展望？

答：您好！2026 年半年度公司实现营业收入 73,274.64 万元，同比增长 61.53%；归属于母公司股东的净利润为 13,743.21 万元，同比增长 104.69%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为 13,342.39 万元，同比增长 111.20%；有关公司全年业绩情况请关注公司后续披露的定期报告，感谢您的关注！

3、邱董事长你好！请问公司有市值管理计划吗？

答：您好！公司重视市值管理工作，始终将做好经营管理、提升经营业绩和企业价值作为推动公司市值和内在价值可持续发展的驱动力，以持续、稳定的业绩回报广大投资者，增强投资者信心。感谢您的关注！

4、邱董好！近年光模块市场发展迅猛，请问在光模块领域公司如何抓住这个机遇使公司进入发展快车道？据说已经和美国 **Fabrinet** 公司合作出货数条自动化组装产线，请问与国内光模块厂商是否合作出货？公司对光模式设备的业务定位是怎样的？

答：您好！公司柔性自动化设备以标准化设备平台为基础，通过灵活配置不同的执行模块，实现功能快速切换，从而适配多元化的行业应用场景。2026 年半年度柔性自动化业务实现营业收入 3,363.56 万元，同比增长 37.22%，公司光模块自动化组装线持续出货。光模块自动化整线方案覆盖多领域光模块场景，采用龙门双驱直线电机架构，经仿真优化，将 FMS 模块化标准设计理念与统一软件框架深度融合，最终实现光模块组装段全流程自动化。最高产能（UPH）达 400pcs；支持不停机换料，支持模块化切换执行单元；重复定位精度±5 μm，组装精度±25 μm；符合 CE 安全标准；过程能力指

数 $CPK \geq 1.67$ ，支持全流程智能化管控与远程运维。公司的光模块自动化整线解决方案已实现海外批量交付。同时，公司积极布局光通信领域，推出用于 COC/COS/TO 等产品的脉冲加热共晶机，计划推出隔离器、透镜类点胶设备，储备了光模块领域专用设备技术。感谢您的关注！

5、邱董好！上半年公司封装业务营收利润打增长，请问后期公司这块发力点在哪里？

答：您好！2026 年半年度公司封装设备实现营业收入 16,257.00 万元，同比增长 174.72%，主要系产品经研发迭代升级后，在客户端的使用成本、产出效率、品质管控等方面均有较大提升，获得客户广泛认可，客户数量持续增长，市场占有率稳步提升。后续公司将持续加大 Mini/Micro LED 固晶机的拓展，随着下游 LED 显示技术日趋成熟、市场需求的提升，公司将继续发挥 LED 固晶机在芯片小型化趋势下设备效率及稳定性的优势，进一步提升市场占有率。其次，公司将加快封装设备在高端应用领域的切入步伐。2026 年半年度公司高精度固晶机获得通讯行业客户的认可，且多款封装设备成功切入 SIP、COB、COG、MiP 等细分领域。感谢您的关注！

6、邱董好！据说玻璃基板印刷设备价格是普通基板印刷设备价格近十倍，请问是否属实？公司对玻璃基这块业务发展如何，市场竞争力怎样？

答：您好！公司锡膏印刷设备主要应用于 SMT（表面贴装技术）及 COB（Chip on Board）工艺中的印刷工序，通过将锡膏精准印刷至 PCB 或基板上，实现电子元器件/裸芯片与 PCB 裸板/基板的固定粘合及电气信号连接。同时，该设备还可用于半导体封装领域，通过将锡膏、银膏或环氧树脂等材料均匀印刷至焊盘或晶圆表面，实现芯片与基板间的电气互联。下游应用广泛，产品型号众多，根据客户工艺需求，适

	配不同产品型号。公司 X60 满足玻璃基无需载具的印刷工艺，适配 Mini LED COG 路线显示需求。公司锡膏印刷设备在电子装联领域已处于全球先进水平，并前瞻性开发储备了 3D 钢网印刷、植球、智能点锡等关键技术及产品，以适配封装工艺向 CoWoS/CoWoP 的技术演进。感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 3 日